



2026年6月12日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者 代表取締役社長 石井 常路
(コード番号6125 東証 スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 高橋 正弥
(TEL. 027-385-5800)

第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年5月22日付「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」において開示いたしました第三者割当増資（以下「第三者割当」という。）の「調達する資金の額、使途及び支出予定時期」における金額および支出予定時期の一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2024年5月22日付「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本第三者割当に係る調達資金について、下記「2. 変更の内容（変更前）」に記載のとおり資金使途に充当することを予定しておりましたが、当初想定していた新規の不動産（土地）購入および建築を行う計画から、中古不動産を取得のうえ改修する計画へと変更したことにより、設備投資に係るコストの削減が可能となりました。この結果、設備資金として予定していた下記①の支出金額については、当初予定していた57億円から17.3億円へと大幅に減額することといたしました。なお、下記①に記載の技術開発棟およびショールームとして活用する施設につきましては、2025年12月に開設を完了しております。また、下記①に係る設備投資のうち、当該技術開発棟およびショールームに導入する一部設備につきましては、納入時期が当初計画から後ろ倒しとなる見込みであります。これは、発注済み設備の製造及び納品までに要する期間が当初想定を上回っていることによるものであり、これに伴い当該資金使途に係る支出予定時期を変更することといたしました。

さらに、上記技術開発棟およびショールームとして活用する施設については、技術開発棟としてのラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用を図るため、開設後も必要な機能強化を段階的に進めていくことが重要であると判断しております。このため、減額後の設備資金の一部については、下記⑤に記載のとおり、これらの目的に資する設備資金および改修工事等に活用する方向で検討しておりますが、現時点において具体的な実施内容、金額および支出予定時期は未定であります。

また、当初計画していた下記④につきましては、当社連結子会社である大和工機株式会社における設備投資案件でありましたが、グループ全体の設備投資計画及び投資優先順位を見直した結果、必要最低限の設備更新については大和工機株式会社の自己資金により対応可能であると判断したため、当該設備投資計画を見送ることといたしました。

これらの見直しにより、①および④において減額した資金のうち、下記⑤に係る資金を除く残額につきましては、下記⑥に記載の通り、今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用について現在検討を進めております。

なお、現時点において、下記⑤および⑥に係る具体的な金額、資金使途ならびに支出予定時期は未定であり、未充当資金として適切に管理しております。

今後、下記⑤および⑥の具体的な資金使途が決定した場合には、その内容及び支出予定時期について速やかに開示いたします。

2. 変更の内容

本第三者割当により調達した資金使途の金額および支出予定時期の変更内容は、以下のとおりです。
(なお、変更箇所は下線で示しております。)

(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	5,700	2024年8月～2026年3月
② 次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年8月～2026年3月
③ 半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年6月～2026年2月
④ 大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	800	2024年10月～2025年9月

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	<u>1,731</u>	2024年8月～ <u>2027年3月</u>
② 次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年8月～2026年3月 (充当済)
③ 半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年6月～2026年2月 (充当済)
④ 大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	—	—
⑤ <u>①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金(予定)</u>	<u>未定</u>	<u>未定</u>
⑥ <u>今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用(詳細未定)</u>	<u>未定</u>	<u>未定</u>

3. 業績への影響

資金使途の金額および支出予定時期の変更による当期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、開示の必要性が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上